

证券代码：002745

证券简称：木林森

木林森股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2019-001

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 媒体采访 ☐ 新闻发布会 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）	分析师会议 ☐ 业绩说明会 ☐ 路演活动
参与单位名称及人员姓名	陶胤至 中信建设；徐进 万家投资；杨欣 银华基金；施柏均 青沣资产；彭雾 广发证券；唐弘翼 国信证券；刘明、金龙 东方阿尔法；亓辰 易方达；江政琦 安信农保；冯明远信达澳银；苏晓伟 重器资产；李子扬 合煦智远；曹佳、李委驰 钜洲投资；刘翔 天平洋证券；王谋 博时基金；张雪薇 景顺长城；刘旭 泰康资产，共 19 家机构。	
时间	2019 年 1 月 9 日	
地点	中山市小榄镇木林森大道 1 号 1 楼会议室	
上市公司接待人员姓名	董事长孙清焕、财务总监易亚男、董事会秘书李冠群	
投资者关系活动主要内容介绍	问题 1、主营业务在行业处于什么阶段，未来的格局怎么变化，木林森未来在行业的变化的位置？ 回答：原来木林森的主业主要是封装，朗德万斯整合并入上市公司以后，公司分两个主要的板块，个人的定义一个板块为制造板块，另一个板块为品牌渠道，首先制造板块建立在封装领域的多年布局，在 LED 这个行业，产品能够多样化。制造板块未来主要是围绕灯珠、线路板及电源控制这三大块。另一个板块品牌渠道很大的程度上带动木林森的制造板块，2018 年第四季度，两个板块的联动效应开始体现。主要是通过经营理念的磨合，加强产品的标准化，降低生产成本。同时，也与国外的大光源厂商有了更好的合作，在品质和供应上得到充分的保障，竞争力也进一步提升。 问题 2、目前阶段性的有些困难，未来一年有哪些困难，如何应对这些困难？ 回答：2018 年受到大环境的影响，总需求在大环境的变化下有所放缓，芯片产能过剩，导致照明产品价格竞争较大。应对的措施：充	

	分利用现有的设备和厂房，对固定资产的投入进行控制与调整。按照现有的市场，公司未来在小间距的显示屏灯珠封装通过技术的革新，来应对预期的困难，白光方面维持稳定的产量，并且还在进一步优化产品结构，且产品的出口量上有上涨。 问题 3、对今年照明市场的看法？ 回答：我个人认为照明市场的产品分两类：一类是出口有专利高端的产品，另一类是在新兴市场以性价比为主导产品，在市场大环境不好的情况下，大家就更在意性价比，在白光 LED 产品方面，木林森有相对明显的优势。高端产品在朗德万斯带动国外高端的灯珠的需求和开发晶的合作解决了专利出海口问题。 问题 4、如何看待库存较高的问题？ 回答：我们一直在调整产品结构，通过产品结构的转换去调整库存的结构。 问题 5、芯片的价格和终端产品价格的是否存在传导机制？ 回答：有传导机制，芯片价格下降，封装企业的价格也会有一定的下降幅度。但是芯片占封装的成本越低，个人认为对木林森越有优势。 问题 6：合计报表预计负债的增加是因为什么原因？ 回答：是朗德万斯合并以后计提的重组费用。 问题 7：木林森制造端经验如何做好品牌渠道端？ 回答：第一通过研讨把握总体大方向，由专业的营销团队负责品牌渠道，专业的事情给专业人做，第二个人认为不管是品牌还是营销，最主要的还是核心竞争力的产品。通过最有核心竞争力的产品去带动品牌和渠道端。 问题 8：今年对短期负债的有哪些安排？ 回答：我们的有息负债在我们可控的范围内，看到的短期负债比较高，其实我们是有对冲风险的，有一部分是以票据作为融资，这一部分可以对冲，对冲以后我们的短期负债率会下降，而且这一部分有全额的保证金。我们在整个盘子可控的情况下，为了降低融资成本，我们在同行相同规模的融资，我们融资成本是低于同行的，所有的融
--	--

	资风险是可控的。
附件清单（如有）	无
日期	2019 年 1 月 10 日